

AI時代に向けたものづくり 産業成長戦略サロン



xEV・AIデータセンターが牽引する 次世代パワー半導体最前線

2026年9月7日(月)

14:00~16:35 (受付開始13:30)

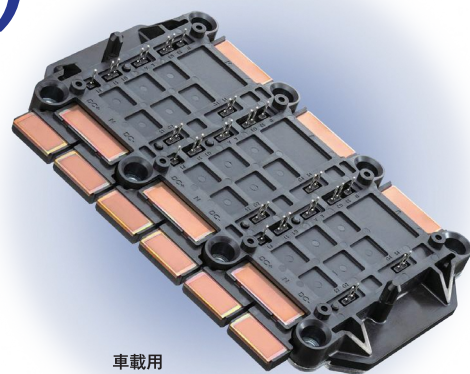
会場：京都経済センター3階 会議室3-F

(京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地)

定員：50名(先着順)

参加費無料

主催：AI時代に向けた京都ものづくり産業の成長戦略実行委員会



車載用
SiCモジュール

AIデータセンターの急拡大や電動車（xEV）の普及を背景に、電力需要はこれまでにない規模で増加しています。その中で、省エネルギー化と高性能化を両立する次世代パワー半導体が重要な技術として期待されています。

特にSiCを用いたパワー半導体は、従来のシリコン半導体と比べて電力損失を大幅に低減できることから、電動車やAIデータセンター、再生可能エネルギー分野など幅広い用途で採用が進んでいます。

また、性能向上を支えるパワーモジュールやパッケージ

技術についても開発競争が加速しています。

本セミナーでは、名古屋大学の山本真義教授より、xEVやAIデータセンターにおける次世代パワー半導体・センサ応用技術の最新動向や今後の市場展望についてご講演いただきます。また、富士電機株式会社より、立体構造SiCパッケージをはじめとした次世代パワーモジュール技術についてご紹介いただきます。

パワー半導体市場の最新動向から実際の製品技術までを学び、関連サプライチェーンにおける新たな事業機会を探る機会として開催いたします。

◎プログラム内容・会場アクセス・参加申込みは裏面を➡

AI時代に向けたものづくり産業成長戦略サロン

xEV・AIデータセンターが牽引する次世代パワー半導体最前線

プログラム内容

※講演タイトル、講演者は都合により変更する場合があります。予めご了承下さい。

●14:00~15:00 (60分)

講演① 「電動車(xEV)やAI用データセンターに求められる 次世代パワー半導体・センサ応用技術とその市場予測」

名古屋大学未来材料・システム研究所／名古屋大学大学院工学研究科電気工学専攻 教授 山本 真義 氏

●15:05~15:45 (40分)

講演② 「立体構造SiCパッケージをはじめとした 次世代パワーモジュール技術」

富士電機株式会社 半導体事業本部 営業統括部 応用技術部 部長 大月 正人 氏

15:45~15:55 休憩

●15:55~16:35

交流会

※講師との情報交換や個別相談など

会場 ACCESS

京都経済センター 3階 会議室3-F

所在地：京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地



- 公共交通機関をご利用の場合
 - ・京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」北改札出てすぐ
 - ・阪急電車京都線「烏丸駅」26番出口直結
 - ・京都市営バス「四条烏丸」徒歩すぐ
 - ・京都市営地下鉄「京都駅」より烏丸線乗車3分
 - ・阪急電車「河原町駅」より京都線乗車2分
 - ・京阪電車「祇園四条駅」下車市営バス「四条京阪前」より乗車約9分
- お車をご利用の場合
 - ・大阪方面からのお越しの場合…名神高速道路京都南ICから約20分
 - ・名古屋方面からのお越しの場合…名神高速道路京都東ICから約20分
 - ・阪神高速8号京都線上烏羽ランプから約20分



参加申し込み方法

以下URL、または右記二次元コードよりお申し込みください。

定員：50名(先着順) **参加費無料**

●ご提供頂いた個人情報は、本セミナーの参加者資料として使用し、ご本人の同意なく目的以外の利用を行うことはございません。

<https://www.ki21.jp/entries/form/view/index.php?id=798326>



申込締切

**2026年
8月31日(月)**

問い合わせ先

公益財団法人京都産業21 イノベーション推進部
京都市下京区中堂寺南町134

■電話：075-315-8677 ■メール：semicon@ki21.jp



公益財団法人
京都産業21

